

## CdTe半導体検出器を用いた ミュオンX線の撮像 Nov. 27, 2020 <sub>桂川 美穂</sub> 東京大学カブリIPMU

計測システム研究会2020

## Outline

# \* ミュオンX線を用いた非破壊分析の現状と課題 \* CdTe半導体検出器を用いた小型カメラの開発 \* J-PARCにおける実験 \* まとめ



物質にダメージを与えることなく構成元素や量、分布を特定する分析手法 <u>蛍光X線分析 (XRF)</u>



計測システム研究会2020

## ミュオンビーム@J-PARC



## ミュオンX線の1次元測定

Ge spectra

Terada et al. (2014)



<u>ただし、スペクトル情報のみ!</u>

Intensity

## ミュオンX線の1次元測定

Ge spectra

Terada et al. (2014)



#### New approach

2次元情報(硬X線撮像)を取り入れて3次元撮像を可能にする。

Intensity

## 宇宙観測用CdTe半導体検出器

#### <u>ASTRO-H(ひとみ衛星)</u>

Hard X-ray Imager (HXI)



両面ストリップ型CdTe検出器 CdTe double-sided strip detector (CdTe-DSD)





## CdTe半導体素子



At, Ptのストリップ電極を各面に直交する様にとりつけた両面ストリップ型検出器
 -> 少ない読み出しチャンネルの減少による小型化(Strip: 2N, Pixel: NxN)

 ▶ Al/p-CdTe構造によるCdTe ダイオード
 -> High energy resolution

ACRORADとの共同開発

読み出 し ASIC





9



計測システム研究会2020

## CdTe-DSD

#### 1. 高い検出感度 <100 keV

高いエネルギー分解能 ~1-2 keV@60 keV 2. φ3 mm hole 100  $\mu$ m width slit bad strips

800  $\mu$ m pitch

bad strips

15

(b)

•••

(b)

• •

(b)

. .

(b)

(b)

3

20

/ (open)

E 30

25

20

15 Φ3 mm hole

φ2 mm hole

10

5

15

20

25

30

[mm]

φ2 mm hole

25

30

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[ 20 20

25

800 µm pitch

細かい電極幅 3. 4. 小型/低バッ



(a) Takahashi et al. 2001, Wat<mark>anabe et al. 2011</mark> with ACCORD



Φ2 mm hole

/ (open)

#### 小型硬X線カメラ CdTe-DSD + Pinhole optics + Graded-Z shield + Peltier Cooler

# CdTe-DSD Cooling to -20 °C 197 mm × 166 mm × 104 mm バックグラウンド低減のためのピンポール&シールド

# 小型硬X線カメラ





## Momentum control

シミュレーション(TRIM)によって物質中の負ミュオンの停止位置を計算し、 運動量を決定する。(TRIM:A MonteCarlo simulator built in SRIM )



# ビームの時間依存性

ビームの25Hz(40ms)に由来するイベ ントを確認。ただし40ms+α。







## ビームの時間依存性



Δtを指定することで、連続成分のみを減らすことができる。 → 400 ns

ー>現在は2バンチなので、2箇所∆t1, Δt2を使用

## ミュオンX線の検出と同定





## Background study

バックグラウンドのピンホール径への依存性を検証



-> シールドの強化, Multi pinhole, Coded mask

#### コーデッドマスクによるイメージン

ピンホールコリメーターよりも開口面積が 広く、検出効率の向上が可能。

	Value
Size (mm)	18.3 x 17.7 x 0.3
Material	Tungsten
Minimun element	300 µm
Mask pattern	URA*
Absorption rate	95%
*11PA, Uniformly Podundant Array	

\*URA: Uniformly Redundant Array

#### <u>Li Sample</u>

- ø4 mm x 2 mm
- ø8 mm x 2 mm
- ø8 mm x 0.5 mm
- ø8 mm x 1 mm









検出器を3次元的に配置し、複数方向からの 2-D画像をもとに3-D画像を再構成する。



3次元構造を持つサンプルを回転させること で、3-Dイメージングの模擬実験を行った。



#### ビームが当たる表層面の3-Dイメージングに成功

計測システム研究会2020

S

まとめ

CdTe-DSDとピンホールコリメーターを用いた小型硬X線撮像器を開発。
 世界で初めてのミュオンX線イメージングに成功。
 バックグラウンドの低減。

- ・ Graded Zシールド
- ・ 加速器に同期したトリガー用ゲート信号

◆ 今後の課題・取り組み

・ 光学系の最適化(マルチピンホール等)

- さらなるバックグラウンド成分の低減(G4シミュレーション等)
- 3-Dイメージングシステムへ拡張
- はやぶさ2のサンプル撮像に向けた準備

共同研究者:

25

武田伸一郎、藪悟郎、高橋忠幸(カブリIPMU)、渡辺伸(ISAS/JAXA)、反保元伸、三宅康博(J-PARC) 謝辞:

新学術領域研究(研究領域提案型)「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋。」 計測システム研究会2020